博盛花溦



HM100 带外管理模块



HM100为支持IPMI2.0接口协议的小型化带外管理模块,支持上下电控制、温度检测、电压检测、电流检测、处理器资源状态信息获取、健康信息上报及告警等功能;模块采用双冗余备份IPMB管理总线设计,支持11路ADC接口、1路数据通信串口、1路IIC数据通信口、1组槽位地址检测口、5路上下电检测控制口、2路状态指示信号输出以及1路调试串口。

模块尺寸为30mm×20mm×3mm(长×宽×高),同时支持半月孔焊接方式和排针插拔安装方式;模块元器件的国产化率可以实现"穿透式"数量和种类双100%,能够广泛应用于遵循ATCA、CPCI、PXIe、VPX、ASAAC规范研制的电源刀片、计算刀片、交换刀片等各类工控板卡。

HMIDD 带外管理模块 I 示意图

GA0*	1 40	UART_PI_TX
GA1*	2 39	UART_PI_RX
GA2*	3 38	SWDIO
GA3*	4 37	SWCLK
GA4*	5 36	VADC0
GAP*	6 35	VADC1
IPMB-A_SCL	7 34	VADC2
IPMB-A_SDA	8 33	VADC3
SOFT_POWER_OFF	9 32	VADC4
IPMB-B_SCL	10 31	VADC5
IPMB-B_SDA	11 30	VADC6
SYSRST	12 29	IADC0
MO_SCL	13 28	IADC1
MO_SDA	14 27	IADC2
INHIBIT	15 26	IADC3
IPMI_UART_TXD	16 25	PWR_LED
IPMI_UART_RXD	17 24	FRU_LED1A
PAYLOAD_IN	18 23	PWR_CTRL
GND	19 22	GND
VCC	20 21	VCC

关键特点

支持标准IPMI2.0 通信协议 双冗余IPMB接口, 更可靠

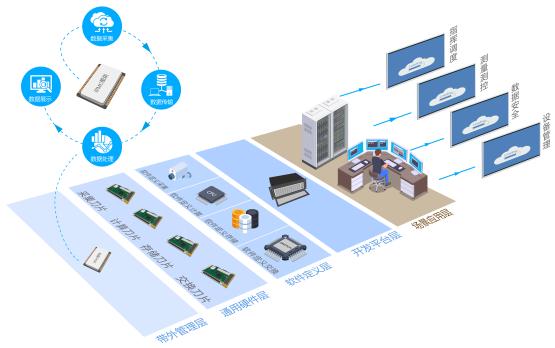
体积小,可用于各类 限高3mm板卡背面

功耗低,无需额外 散热器件 可配置性强 提供图形化界面用 户自行配置

穿透式100% 全国产化

HMIDD 带外管理模块 I 应用场景

- ★ 计算类板卡带外控制及健康管理
- ★ 电源类板卡带外控制及健康管理
- ★ 交换类板卡带外控制及健康管理
- ★ VPX机箱整机健康管理应用



规格参数

硬件平台	
处理器	ARM处理器
存储	支持外挂EEPROM,配置管理信息存储
软件平台	
操作系统	嵌入式时实操作系统
配置界面	支持通过上位机进行端口配置
软件升级	本地升级
	远程升级

接口协议	IPMI2.0
物理接口	双冗余备份IPMB管理总线
ADC接口	ADC×11
数据通讯串口	数据通讯串口×1
数据通讯口	数据通讯口×1
地址检测口	地址检测口×1
电检测控制口	电检测控制口×5
调试串口	调试串口×1

供电	
供电	3.3V@≤1W
物理参数	
重量	≤50g
尺寸	半月孔焊接型模块30mm×20mm×3mm
	排针焊接型模块30mm×20mm×8mm
外壳	洋白铜C7521-H
环境参数	
	商业级 (0℃~70℃)
温度等级	商业级 (0℃~70℃) 工业级 (-40℃~80℃)
	, , ,
	, , ,
温度等级国产化率	, , ,
温度等级	工业级 (-40℃~80℃)